



SEMINAIRE TECHNIQUE

vendredi 1 juillet 2016
De 9h30 à 15h00



Réussir l'industrialisation des produits électroniques

Vous avez une maquette ou un prototype qui fonctionne, il faut maintenant fabriquer une pré-série puis une série et cela sans défaut au meilleur coût !

Réussir l'industrialisation, cela passe par une meilleure connaissance de tous les acteurs de la « supply chain » électronique ; **le concepteur de carte (CAO), le fabricant de circuit imprimé (PCB) et l'assembleur sont d'égale importance.**

Nous vous proposons de mieux connaître tous ces métiers et de visiter Micropacc la plateforme dédiée à la conception et la fabrication électronique qui propose du transfert de technologie et des services.

Objectifs : Permettre aux concepteurs de produits de réussir une fabrication de qualité par une meilleure connaissance des technologies de base de la production de cartes. Ces témoignages d'industriels vous aideront à faire les bons choix et éviter les problèmes potentiels de fabrication afin d'améliorer la fiabilité de vos systèmes électroniques.

Personnes concernées : Responsables de Projets, Ingénieurs, Techniciens en charge de la conception et de la qualité du développement des systèmes électroniques.

PROGRAMME

<p>9H15 - 9h30 Accueil des participants</p> <p>Introduction générale, la conception de cartes électroniques Marc Alary, MICROPACC</p> <ul style="list-style-type: none">- Présentation du brasage tendre,- Présentation des filières d'assemblage industrielles classiques (vague et refusion),- Technologies et contraintes de conception et fabrication liées aux procédés d'industrialisation- Rappel des étapes de l'Industrialisation cartes électroniques, conception/réalisation outillages, couts, délais.- Retour d'expérience, sur les erreurs liées aux faiblesses dans le cahier des charges. <p>Témoignages d'entreprises :</p> <p>L'industrialisation et la gestion des sous-traitants par Frédéric Mailles, TDM</p>	<p>La CAO ou placement/routage de carte</p> <ul style="list-style-type: none">- Les règles de base à respecter lors du tracé des circuits imprimés, choix des matériaux et des finitions principales <p>Rappel des contraintes CEM et filières (aéro, spatial, automobile, grand public)</p> <p>Le Circuit Imprimé ou PCB, par Eric de Ponthaud, CSI</p> <ul style="list-style-type: none">- Rapide explication de la fabrication d'un multicouche.- Retour d'expérience sur les circuits HDI. (pvia & diamètres de perçage, ratio de perçage, densification totale ou seulement sur une zone: impact, combinaison de difficultés (matériaux, dimension, épaisseur de cuivre)- Différentes finitions (HAL, HAL lead free, Sn chimique, ENIG) <p>L'assemblage des cartes, Didier DUGARRY, FEDD</p> <p>Retour d'expérience en assemblage, contraintes et difficultés, les erreurs de conception.</p> <p>13h00 Buffet</p> <p>Visite de la plateforme Micropacc</p>
--	--

Lieu : Micropacc - Lycée Bourdelle - 3 Boulevard Edouard Herriot - 82003 Montauban Cedex

Prix : Les frais liés à l'organisation de ce séminaire sont pris en charge par Micropacc

Inscription obligatoire : [Inscription obligatoire en ligne](#)